

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

PCT

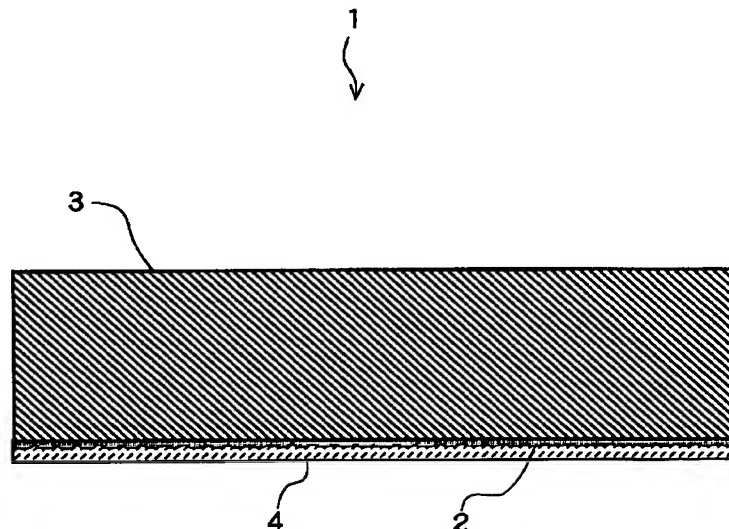
(10) 国際公開番号
WO 2005/009093 A1

- (51) 国際特許分類: H05K 1/03 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010101 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐藤 哲朗
(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 15 日 (15.07.2004) (SATO, Tetsuro) [JP/JP]; 〒3620013 埼玉県上尾市鎌倉
(25) 国際出願の言語: 日本語 橋 6 5 6-2 三井金属鉱業株式会社 銅箔事業本部 銅
(26) 国際公開の言語: 日本語 箔事業部内 Saitama (JP). 松島 敏文 (MATSUSHIMA,
Toshifumi) [JP/JP]; 〒3620021 埼玉県上尾市原市
(30) 優先権データ: (74) 代理人: 吉村 勝博 (YOSHIMURA, Katsuhiko); 〒
特願2003-277428 2003 年 7 月 22 日 (22.07.2003) JP 3300854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2 丁目 5-4
特願2004-172985 2004 年 6 月 10 日 (10.06.2004) JP 大宮 F ビル 吉村国際特許事務所 Saitama (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
金属鉱業株式会社 (MITSUI MINING & SMELTING 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1418584 東京都品川区大崎一丁 BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
目 1 1 番 1 号 Tokyo (JP). DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: COPPER FOIL WITH EXTREMELY THIN ADHESIVE LAYER AND METHOD FOR PRODUCING THE COPPER FOIL WITH EXTREMELY THIN ADHESIVE LAYER

(54) 発明の名称: 極薄接着剤層付銅箔及びその極薄接着剤層付銅箔の製造方法



(57) Abstract: A copper foil with an extremely thin adhesive layer (1) for use in a printed wiring board which has a copper foil (3) having not been subjected to a roughening treatment and, provided on one surface thereof, an extremely thin primer resin layer for the purpose of securing good adhesion to a resin substrate, characterized in that it has a silane coupling agent layer (2) on the surface of the above copper foil having not been subjected to a roughening treatment having a surface roughness (Rz) of 2 μ m or less and has, on the silane coupling agent layer (2), an extremely thin primer resin layer (4) having a converted thickness of 1 to 5 μ m; and the like. The copper foil can be advantageously used as a copper foil which has not been subjected to a roughening treatment and has an extremely thin adhesive layer formed thereon.

(57) 要約: 粗化処理を施していないプリント配線板用の極薄樹脂層付銅箔の提供を目的とする。この目的を達成するため、粗化処理の施されていない銅箔 3 の片面に樹脂基材との良好な張り合わせ密着性を

[続葉有]



ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書・説明書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

確保するための極薄プライマー樹脂層を設けた銅箔であって、前記粗化処理の施されていない銅箔の表面粗さ (R_z) が2 μm以下である面に、シランカップリング剤層2を備え、そのシランカップリング剤層2の上に換算厚さが1 ~ 5 μmの極薄プライマー樹脂層4を備えたことを特徴とするプリント配線板用の極薄接着剤層付銅箔1等を採用する。